

LCP

日本新石油化学MG350BPRL/PRL连接器专用LCP塑胶原料欢迎咨询

产品名称	LCP 日本新石油化学MG350BPRL/PRL连接器专用LCP塑胶原料欢迎咨询
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

塑胶原材料大部是从一些油类中提炼出来的，最熟悉的部分PC料是从石油中提炼出来的，PC料在烧的时候有一股花果腐烂臭味,有炭头分子，;ABS是从煤炭中提炼出来的, ABS在烧完灭掉的时候会呈烟灰状，不起泡;POM是从天然气提炼出来的,POM在烧完的时候会有一股非常臭的瓦斯味，白色烟雾。

6T塑胶材料连接器厂家表示，这种材料一般是用在2.54间距贴片排母，和1.27间距/2.0间距系列排母上。耐焊接温度在260度-290度之间，所以使用这种材料生产的排母连接器成本略高，选择这种材料一般是客户在产品上有质量的要求。

有些塑料是可燃的;

可挤出的塑料是热塑料——它们在加热时熔化并在冷却时再次凝固。熔化塑料的热量从何而来？进料预热和筒体/模具加热器可能起作用而且在启动时非常重要，但是，电机输入能量——电机克服粘稠熔体的阻力转动螺杆时生成于筒体内的摩擦热量——是所有塑料最重要的热源，小系统、低速螺杆、高熔体温度塑料和挤出涂层应用除外。

塑胶原料问世仅一百多年，但其发展得却非常的快，这是因为塑胶原料具有许多卓越而独特的性能所赋予的

医疗器械：可在134℃下经受3000次循环高压灭菌，这一特性能满足灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备的制造，加上它的抗蠕变和耐水解性，用它可制造需高温蒸汽消毒的各种医疗器械。尤为重要的是PEEK无毒、质轻、耐腐蚀，是与人体骨骼最接近的材料，因此可采用PEEK代替金属制造人体骨骼。

通用塑料这类塑料是一类用途十分广泛的塑料，它产量大，约占塑料总产量的四分之三，价格低，大量用来制作受力不大的日用品，如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切。

切，成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

光学镜片等级，非常低的双折射特性高透明度低双折射低荧光低吸湿性使用

用作化工防腐蚀泵的壳体、叶片、齿轮泵的齿轮、阀门、管配件及衬里、单向阀的零件、密封件的试验器皿等；

LCP塑胶原料可以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。

按照应用范围分主要有通用塑胶如PE/PP/PVC/PS等,工程塑胶如ABS/POM/PC/PA等常用的几种。另外还有一些特殊塑胶如耐高温高湿及耐腐蚀及其他一些为专门用途而改性制得的塑胶。

LCP塑胶原料全称LIQUID CRYSTAL POLYMER，中文名称液晶聚合物。

减摩、耐磨性能好 大多数塑胶原料具有优良的减摩、耐磨和自润滑性能，它们既可以在水、腐蚀介质中正常工作，也可在边界摩擦和干摩擦条件下有效地工作，比金属要低很多，只有金属要好得多，通常塑胶原料的摩擦系数，比金属要低得多，只有金属的几分之一到十几分之一，因此可用塑胶原料制作许多减摩和耐磨制品。

聚合物:指聚合过程所产生的纯材料或称聚合材料。无论天然树脂还是合成树脂均属高分子合聚物，简称高聚物。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。